

超配（维持）

板块景气加速上行，经营业绩同比高增

半导体行业 2025 年报&2026 年一季报业绩综述

2026 年 5 月 22 日

投资要点：

分析师：刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

■ **半导体板块整体业绩：行业景气延续，业绩同比增长。**半导体行业所有上市公司2025年实现营业收入合计7049.87亿元，同比增长12.79%，实现归母净利润457.53亿元，同比增长38.38%；板块2026Q1实现营收1926.98亿元，同比增长24.71%，2026Q1实现归母净利润254.02亿元，同比增长178.59%。在AI算力需求持续高景气以及关键领域国产替代加速推进等多重因素驱动下，半导体行业2025年和2026年一季度延续复苏向上趋势，行业整体业绩实现较快增长，且利润端表现明显优于收入端，行业景气度持续提升。与此同时，高性能算力芯片、先进制程及先进封装等方向需求旺盛，并逐步向上游设备、材料、零部件等产业链环节传导，带动半导体全产业链进入新一轮景气上行周期。

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

■ **细分板块业绩：**1) **半导体设备：**板块26Q1实现营收257.54亿元，同比+28.56%，26Q1实现归母净利润46.17亿元，同比+63.25%。板块2026Q1销售毛利率为40.47%，同比下降0.74个百分点，销售净利率为17.63%，同比提高3.55个百分点。受益国产替代持续推进，板块26Q1业绩同比增长；2) **半导体材料：**板块26Q1营收同比+24.40%，归母净利润同比-34.98%；2026Q1销售毛利率为19.13%，同比下降1.31个百分点，销售净利率为2.60%，同比下降1.94个百分点。报告期内，行业景气上行、晶圆厂稼动率提升拉动材料消耗增加，但部分企业“扩产+研发+折旧”和财务成本显著上升，因此26Q1归母净利润为负，拖累板块整体业绩；3) **数字芯片设计：**板块26Q1营收同比+79.37%，归母净利润同比+517.74%；板块2026Q1销售毛利率为47.31%，同比提高14.29个百分点，销售净利率为25.38%，同比提高17.80个百分点。报告期内，存储板块景气高企，产品价格持续上行，而算力芯片的国产替代进程持续推进，带动板块26Q1实现业绩高增，盈利能力同比大幅提高；4) **模拟芯片设计：**板块26Q1营收同比+23.72%，归母净利润同比-485.44%；板块2026Q1销售毛利率为33.95%，同比下降0.99个百分点，销售净利率为-1.10%，同比下降1.31个百分点。报告期内，行业景气有所修复，板块营收同比增长，但部分企业扩张与研发投入拉高费用端，叠加产品均价承压导致毛利率修复不及预期，导致板块26Q1归母净利润为负，整体盈利能力承压；5) **半导体封测：**板块26Q1营收同比+14.21%，归母净利润同比+38.51%；2026Q1销售毛利率为15.45%，同比提高1.08个百分点，销售净利率为2.86%，同比提高0.51个百分点。报告期内，AI带动先进封装放价提量，相关公司产能利用率维持高位，板块利润增速明显高于收入增速，且盈利能力有所提升；6) **分立器件：**板块26Q1营收同比-46.82%，归母净利润同比-23.96%，板块2026Q1销售毛利率为26.51%，同比提高7.10个百分点，销售净利率为4.86%，同比提高1.34个百分点。报告期内，板块整体景气度有所修复，但部分企业受到产品价格竞争加剧或海外主体控制权受限等因素影响，盈利能力有所承压，拖累板块整体盈利水平；7)

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

集成电路制造：板块26Q1营收同比+10.90%，归母净利润同比+23.20%，板块2026Q1销售毛利率为20.18%，同比下降1.68个百分点，销售净利率为4.66%，同比下降0.78个百分点。报告期内，国内数据中心算力基础设施建设持续高景气，对高端逻辑芯片代工需求形成强劲拉动，头部晶圆制造企业稼动率持续维持高位，营收规模稳健扩张，但另一方面，新建及扩产产线折旧压力持续释放，也拉低了板块的综合毛利率。

- **投资建议：**人工智能与国产替代双轮驱动，半导体板块2025年、2026年一季度景气高企，营收、归母净利润实现同比高增，且利润端表现明显优于收入端。据SIA，2026年1—3月，全球半导体销售额合计同比增长62.51%，国内半导体销售额合计同比增长59.88%，显示AI需求驱动下行业景气度持续提升，CPU、存储、算力芯片等核心环节持续紧缺。建议关注：存储、CPU、先进封装、模拟芯片、半导体设备与材料等高景气环节。

- **风险提示：**终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。

目录

1. 半导体行业整体业绩：景气向上，利润端增速优于营收端	5
2. 细分板块业绩情况	6
2.1 半导体设备：26Q1 营收同比+28.56%，归母净利润同比+63.25%	6
2.2 半导体材料：26Q1 营收同比+24.40%，归母净利润同比-34.98%	7
2.3 数字芯片设计：26Q1 营收同比+79.37%，归母净利润同比+517.74%	8
2.4 模拟芯片设计：26Q1 营收同比+23.72%，归母净利润同比-485.44%	10
2.5 半导体封测：26Q1 营收同比+14.21%，归母净利润同比+38.51%	11
2.6 分立器件：26Q1 营收同比-46.82%，归母净利润同比-23.96%	12
2.7 集成电路制造：26Q1 营收同比+10.90%，归母净利润同比+23.20%	13
3. 投资建议	14
4. 风险提示	15

插图目录

图 1：半导体板块 2021 年—2025 年营收情况	5
图 2：半导体板块 2021 年—2025 年营收情况	5
图 3：半导体板块 2022Q1-2026Q1 营收情况	5
图 4：半导体板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况	5
图 5：半导体板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率（%）	5
图 6：半导体板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率	5
图 7：半导体设备板块 2021 年—2025 年营收情况	6
图 8：半导体设备板块 2021 年—2025 年归母净利润情况	6
图 9：半导体设备板块 2022Q1-2026Q1 营收情况	6
图 10：半导体设备板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况	6
图 11：半导体设备板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率（%）	7
图 12：半导体设备板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率（%）	7
图 13：半导体材料板块 2021 年—2025 年营收情况	7
图 14：半导体材料板块 2021 年—2025 年归母净利润情况	7
图 15：半导体材料板块 2022Q1-2026Q1 营收情况	8
图 16：半导体材料板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况	8
图 17：半导体材料板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率（%）	8
图 18：半导体材料板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率（%）	8
图 19：数字芯片设计板块 2021 年—2025 年营收情况	9
图 20：数字芯片设计板块 2021 年—2025 年归母净利润情况	9
图 21：数字芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 营收情况	9
图 22：数字芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况	9
图 23：数字芯片设计板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率（%）	9
图 24：数字芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率（%）	9
图 25：模拟芯片设计板块 2021 年—2025 年营收情况	10
图 26：模拟芯片设计板块 2021 年—2025 年归母净利润情况	10
图 27：模拟芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 营收情况	10
图 28：模拟芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况	10
图 29：模拟芯片设计板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率（%）	10

图 30：模拟芯片设计 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率（%）	10
图 31：半导体封测板块 2021 年—2025 年营收情况	11
图 32：半导体封测板块 2021 年—2025 年归母净利润情况	11
图 33：半导体封测板块 2022Q1-2026Q1 营收情况	11
图 34：半导体封测板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况	11
图 35：半导体封测板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率（%）	12
图 36：半导体封测板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率	12
图 37：分立器件板块 2021 年—2025 年营收情况	12
图 38：分立器件板块 2021 年—2025 年归母净利润情况	12
图 39：分立器件板块 2022Q1-2026Q1 营收情况	12
图 40：分立器件板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况	12
图 41：分立器件板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率（%）	13
图 42：分立器件板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率	13
图 43：集成电路制造板块 2021 年—2025 年营收情况	13
图 44：集成电路制造板块 2021 年—2025 年归母净利润情况	13
图 45：集成电路制造板块 2022Q1-2026Q1 营收情况	14
图 46：集成电路制造板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况	14
图 47：集成电路制造板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率（%）	14
图 48：集成电路制造板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率	14

表格目录

表 1：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2026/5/21）	15
---------------------------------	----

1. 半导体行业整体业绩：景气向上，利润端增速优于营收端

半导体板块整体业绩。选取申万分类标准（2021）下“SW 电子——SW 导体”的所有上市公司，统计半导体板块 2025 年全年和 2026 年第一季度业绩情况。截至 2026 年 5 月 18 日，申万半导体板块所有上市公司 2025 年年报、2026 年一季报均已披露完毕。半导体行业所有上市公司 2025 年实现营业收入合计 7049.87 亿元，同比增长 12.79%，实现归母净利润 457.53 亿元，同比增长 38.38%；半导体行业所有上市公司 2026Q1 实现营收 1926.98 亿元，同比增长 24.71%，2026Q1 实现归母净利润 254.02 亿元，同比增长 178.59%。

图 1：半导体板块 2021 年—2025 年营收情况

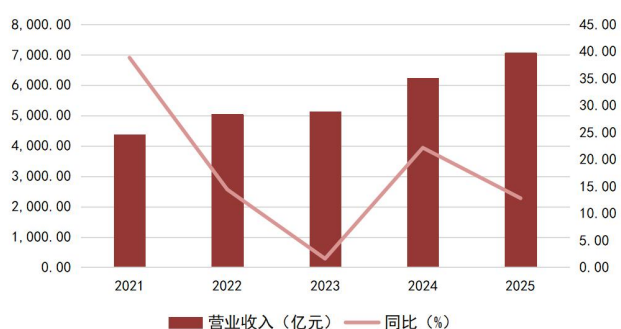
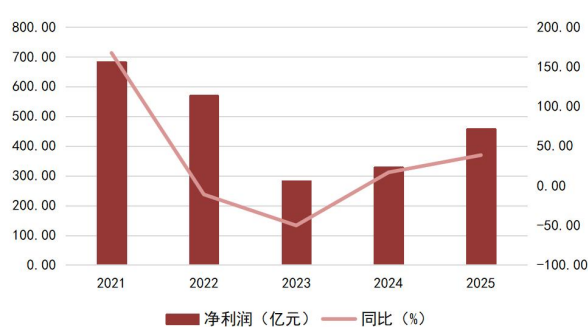


图 2：半导体板块 2021 年—2025 年营收情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 3：半导体板块 2022Q1-2026Q1 营收情况

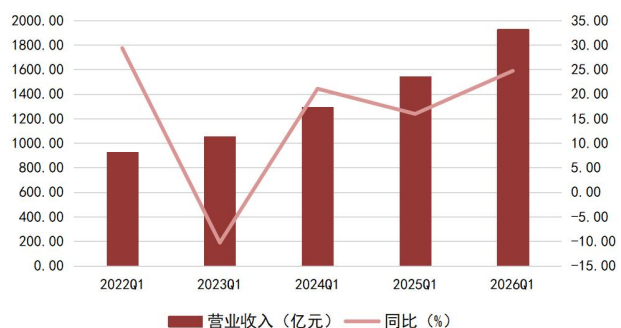


图 4：半导体板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况

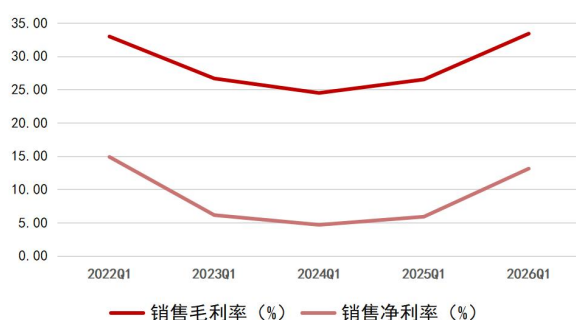
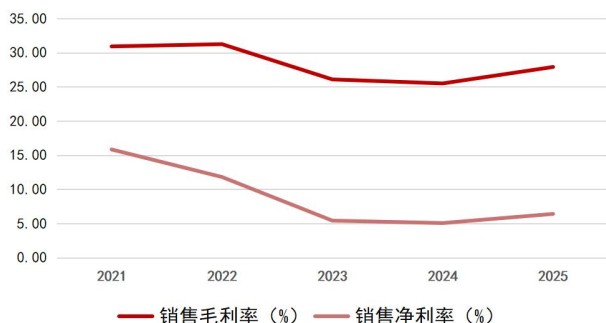


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力同比提高。盈利能力方面，半导体板块 2025 年销售毛利率和净利率分别为 27.88%和 6.39%，相比上年同期分别提高 2.40 个百分点和 1.34 个百分点，2026 年一季度销售毛利率和净利率分别为 33.38%和 13.11%，相比上年同期分别提高 6.88 和 7.22 个百分点。

图 5：半导体板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率 (%) 图 6：半导体板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

综上所述，在 AI 算力需求持续高景气以及关键领域国产替代加速推进等多重因素驱动下，半导体行业 2025 年延续复苏向上趋势，行业整体业绩实现较快增长，且利润端表现明显优于收入端，行业景气度持续提升。与此同时，高性能算力芯片、先进制程及先进封装等方向需求旺盛，并逐步向上游设备、材料、零部件等产业链环节传导，带动半导体全产业链进入新一轮景气上行周期。盈利能力方面，行业销售毛利率及净利率同比均实现明显提升。进入 2026 年一季度，尽管行业处于传统淡季，但在 AI 需求持续爆发及自主可控持续推进背景下，行业整体呈现“淡季不淡”特征，营收、利润及盈利能力均实现进一步改善，行业高景气态势延续。

2. 细分板块业绩情况

2.1 半导体设备：26Q1 营收同比+28.56%，归母净利润同比+63.25%

选取申万半导体行业下的三级行业——“半导体设备”作为半导体设备代表，统计板块 2025 年全年和 2026 年第一季度业绩情况。

板块业绩。半导体设备板块 2025 年实现营收 1036.03 亿元，同比+27.54%，实现归母净利润 153.58 亿元，同比+15.99%；板块 26Q1 实现营收 257.54 亿元，同比+28.56%，26Q1 实现归母净利润 46.17 亿元，同比+63.25%。

图 7：半导体设备板块 2021 年—2025 年营收情况

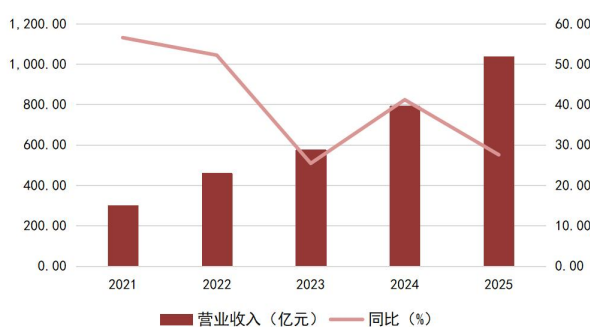
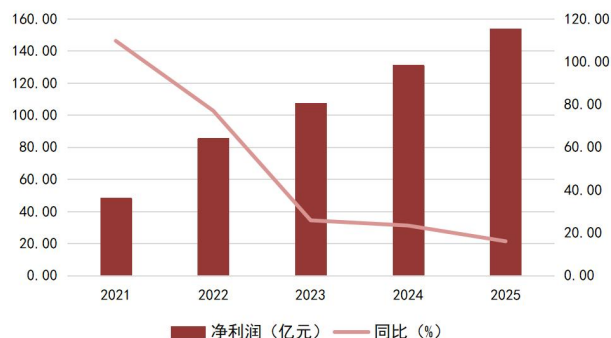


图 8：半导体设备板块 2021 年—2025 年归母净利润情况

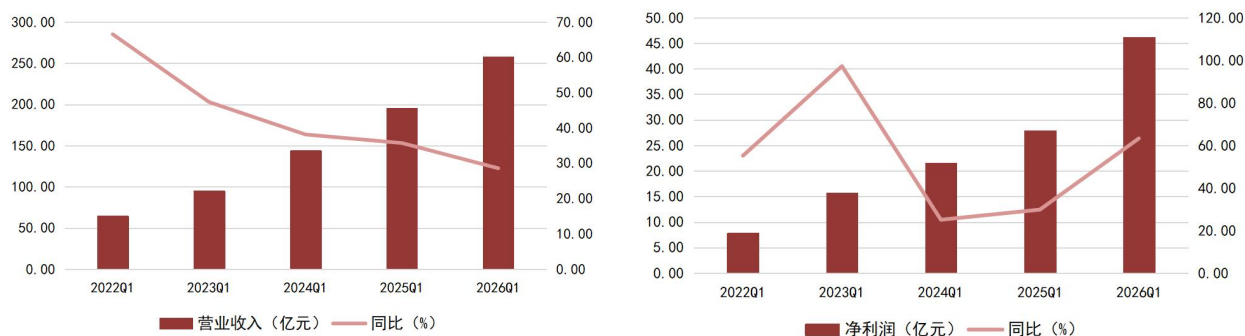


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 9：半导体设备板块 2022Q1-2026Q1 营收情况

图 10：半导体设备板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况

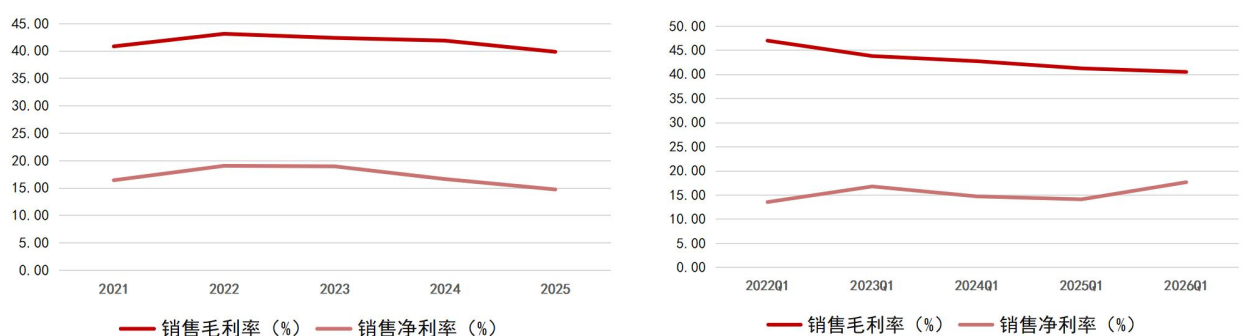


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力。半导体设备板块 2025 年销售毛利率为 39.81%，同比下降 2.04 个百分点，销售净利率为 14.70%，同比下降 1.90 个百分点；2026Q1 销售毛利率为 40.47%，同比下降 0.74 个百分点，销售净利率为 17.63%，同比提高 3.55 个百分点。

图 11：半导体设备板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率图 12：半导体设备板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率（%）



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

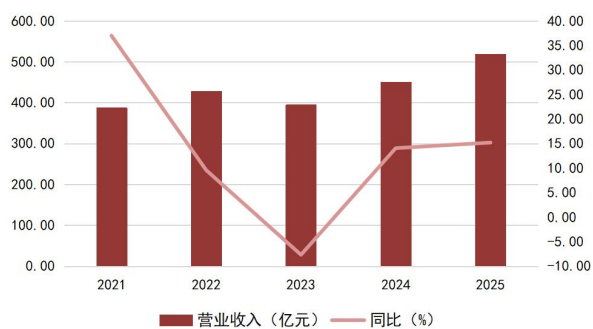
2.2 半导体材料：26Q1 营收同比+24.40%，归母净利润同比-34.98%

选取申万半导体行业下的三级行业——“半导体材料”作为半导体材料代表，统计板块 2025 年全年和 2026 年第一季度业绩情况。

板块业绩。半导体材料板块 2025 年实现营收 518.36 亿元，同比+15.19%，实现归母净利润 12.33 亿元，同比-26.05%。板块 26Q1 实现营收 144.58 亿元，同比+24.40%，26Q1 实现归母净利润 4.08 亿元，同比-34.98%。

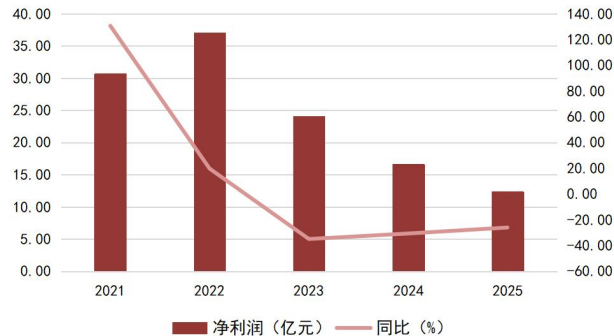
图 13：半导体材料板块 2021 年—2025 年营收情况

图 14：半导体材料板块 2021 年—2025 年归母净利润情况



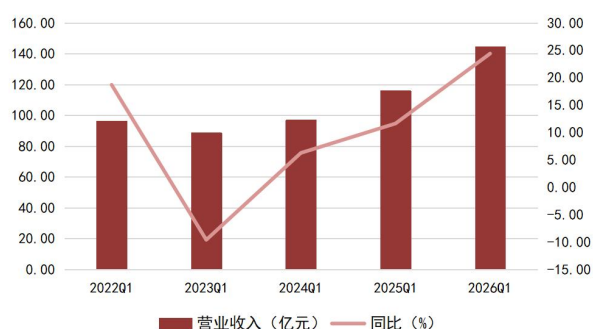
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 15：半导体材料板块 2022Q1-2026Q1 营收情况

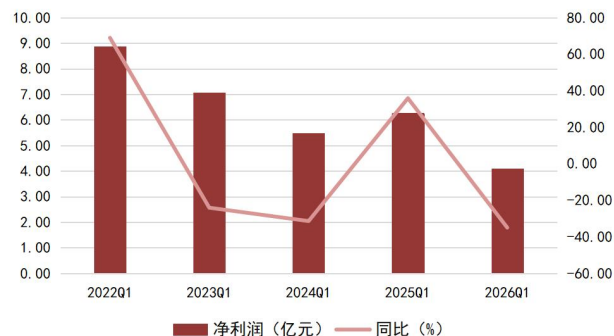


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 16：半导体材料板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况



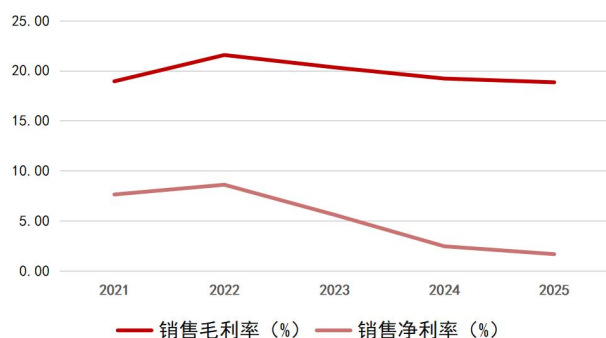
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



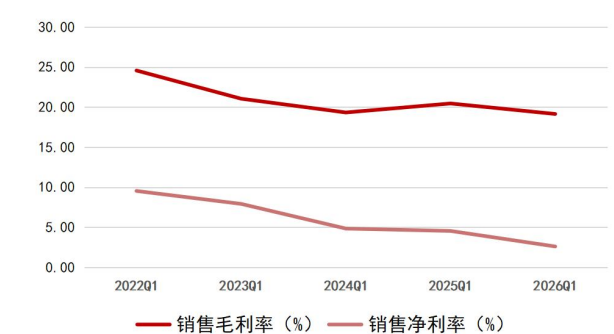
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力。半导体材料板块 2025 年销售毛利率为 18.84%，同比下降 0.37 个百分点，销售净利率为 1.67%，同比下降 0.79 个百分点；2026Q1 销售毛利率为 19.13%，同比下降 1.31 个百分点，销售净利率为 2.60%，同比下降 1.94 个百分点。

图 17：半导体材料板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率图 图 18：半导体材料板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率（%）



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

2.3 数字芯片设计：26Q1 营收同比+79.37%，归母净利润同比+517.74%

选取申万半导体行业下的三级行业——“数字芯片设计”作为数字芯片设计板块代表，统计板块 2025 年全年和 2026 年第一季度业绩情况。

板块业绩。数字芯片设计板块 2025 年实现营收 2017.39 亿元，同比+32.94%，实现归母净利润 209.19 亿元，同比+100.08%。板块 26Q1 实现营收 699.38 亿元，同比+79.37%，

26Q1 实现归母净利润 173.56 亿元，同比+517.74%。

图 19：数字芯片设计板块 2021 年—2025 年营收情况

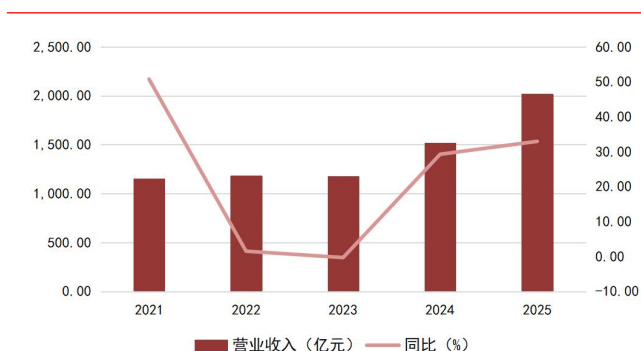
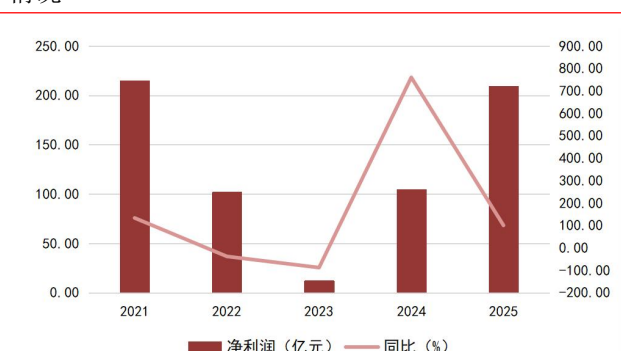


图 20：数字芯片设计板块 2021 年—2025 年归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 21：数字芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 营收情况

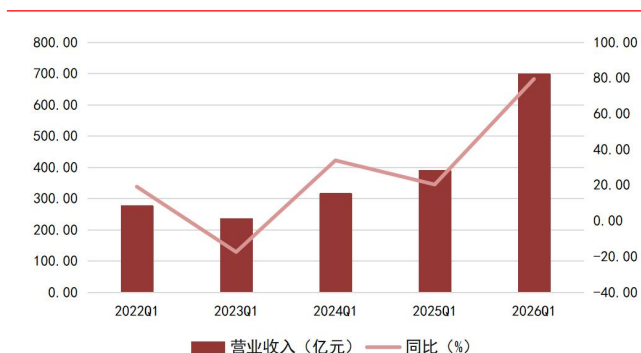
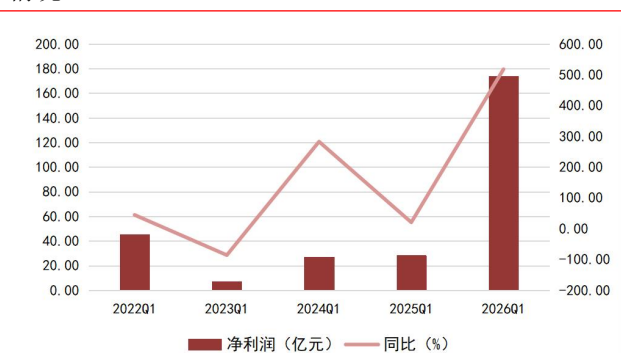


图 22：数字芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力。数字芯片设计板块 2025 年销售毛利率为 34.27%，同比提高 0.50 个百分点，销售净利率为 10.83%，同比提高 3.59 个百分点；2026Q1 销售毛利率为 47.31%，同比提高 14.29 个百分点，销售净利率为 25.38%，同比提高 17.80 个百分点。

图 23：数字芯片设计板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率 (%)

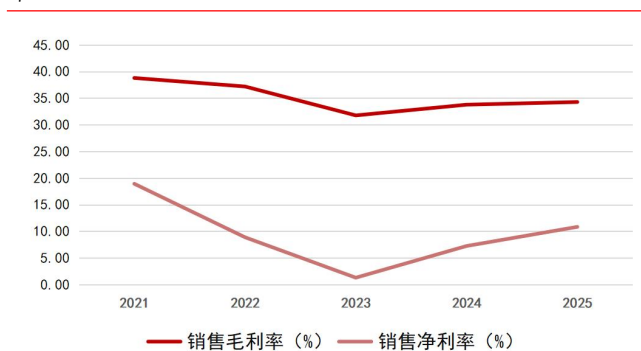
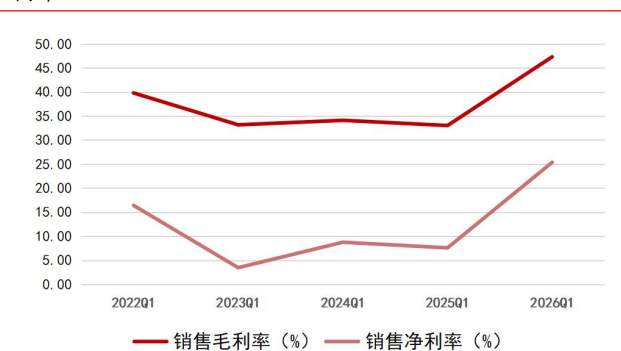


图 24：数字芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率 (%)



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

2.4 模拟芯片设计：26Q1 营收同比+23.72%，归母净利润同比-485.44%

选取申万半导体行业下的三级行业——“模拟芯片设计”作为模拟芯片设计代表，统计板块 2025 年全年和 2026 年第一季度业绩情况。

板块业绩。模拟芯片设计板块 2025 年实现营收 550.98 亿元，同比+15.18%，实现归母净利润 8.51 亿元，同比+566.71%。板块 26Q1 实现营收 138.98 亿元，同比+23.72%，26Q1 实现归母净利润-1.28 亿元，同比-485.44%。

图 25：模拟芯片设计板块 2021 年—2025 年营收情况

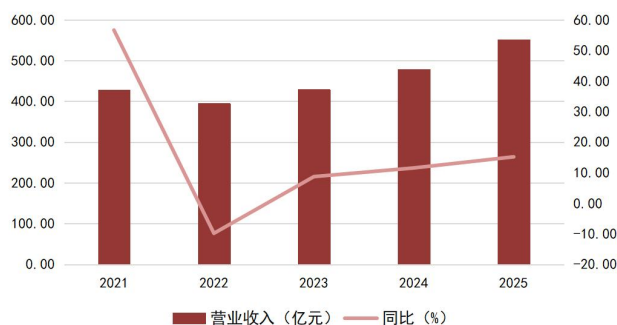
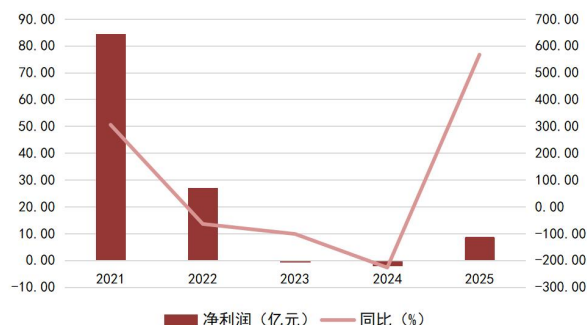
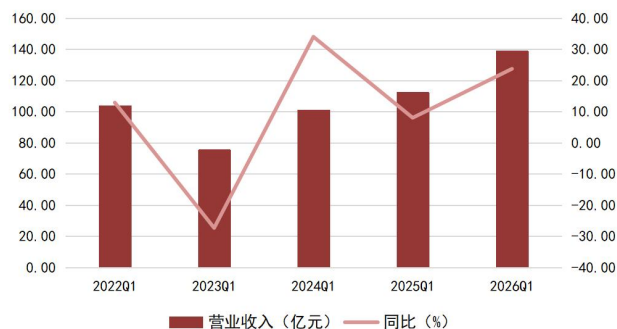


图 26：模拟芯片设计板块 2021 年—2025 年归母净利润情况



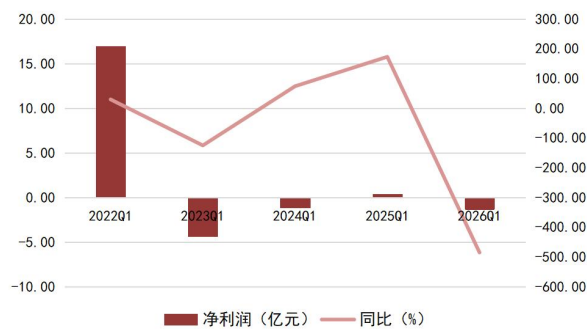
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 27：模拟芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 营收情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 28：模拟芯片设计板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况



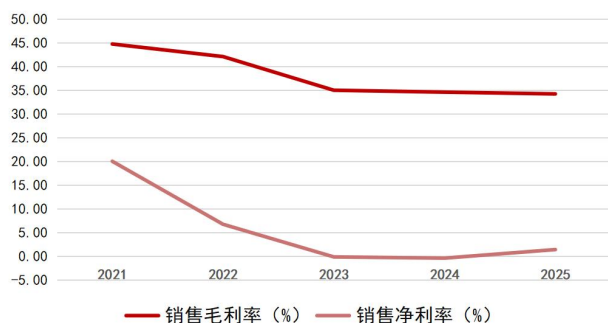
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

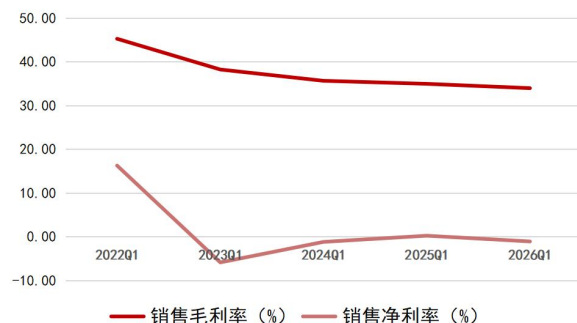
盈利能力。模拟芯片设计板块 2025 年销售毛利率为 34.18%，同比下降 0.37 个百分点，销售净利率为 1.37%，同比提高 1.80 个百分点；2026Q1 销售毛利率为 33.95%，同比下降 0.99 个百分点，销售净利率为-1.10%，同比下降 1.31 个百分点。

图 29：模拟芯片设计板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率 (%)

图 30：模拟芯片设计 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率 (%)



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

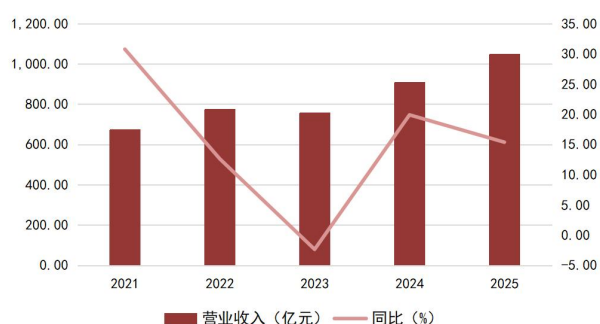
2.5 半导体封测：26Q1 营收同比+14.21%，归母净利润同比+38.51%

选取申万半导体行业下的三级行业——“集成电路封测”作为半导体封测代表，统计板块 2025 年全年和 2026 年第一季度业绩情况。

板块业绩。半导体封测板块 2025 年实现营收 1047.19 亿元，同比+15.37%，实现归母净利润 54.65 亿元，同比+40.23%。板块 26Q1 实现营收 267.23 亿元，同比+14.21%，26Q1 实现归母净利润 7.72 亿元，同比+38.51%。

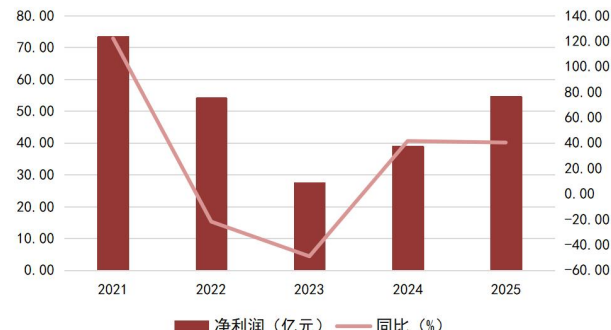
图 31：半导体封测板块 2021 年—2025 年营收情况

图 32：半导体封测板块 2021 年—2025 年归母净利润情况



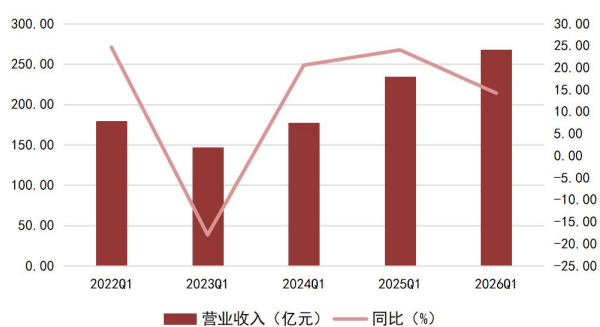
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 33：半导体封测板块 2022Q1-2026Q1 营收情况

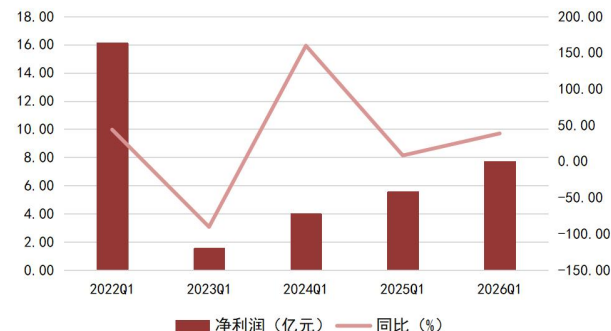


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 34：半导体封测板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

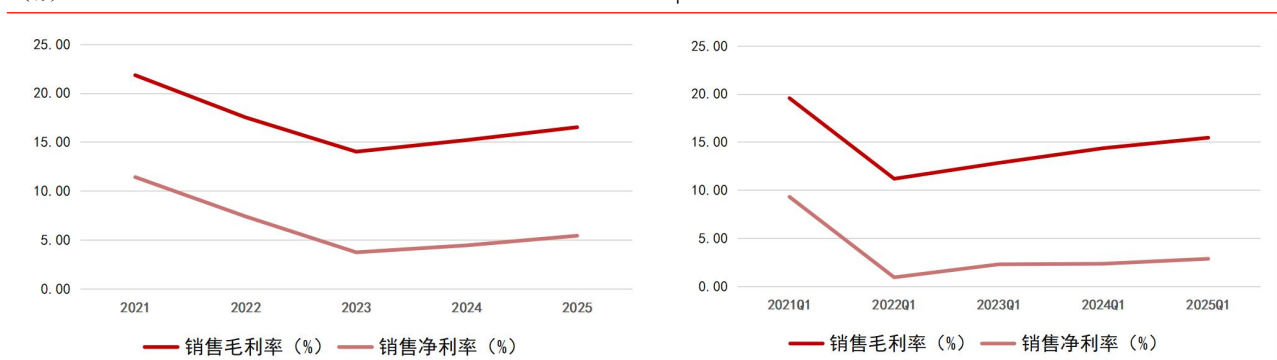


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力。半导体封测板块 2025 年销售毛利率为 16.52%，同比提高 1.31 个百分点，销售净利率为 5.43%，同比提高 0.98 个百分点；2026Q1 销售毛利率为 15.45%，同比提高

1.08 个百分点，销售净利率为 2.86%，同比提高 0.51 个百分点。

图 35：半导体封测板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率图 36：半导体封测板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

2.6 分立器件：26Q1 营收同比-46.82%，归母净利润同比-23.96%

选取申万半导体行业下的三级行业——“分立器件”作为分立器件板块代表，统计板块 2025 年全年和 2026 年第一季度业绩情况。

板块业绩。分立器件板块 2025 年实现营收 717.09 亿元，同比-33.67%，实现归母净利润-56.24 亿元，同比-1669.15%。板块 26Q1 实现营收 116.83 亿元，同比-46.82%，26Q1 实现归母净利润 6.61 亿元，同比-23.96%。

图 37：分立器件板块 2021 年—2025 年营收情况

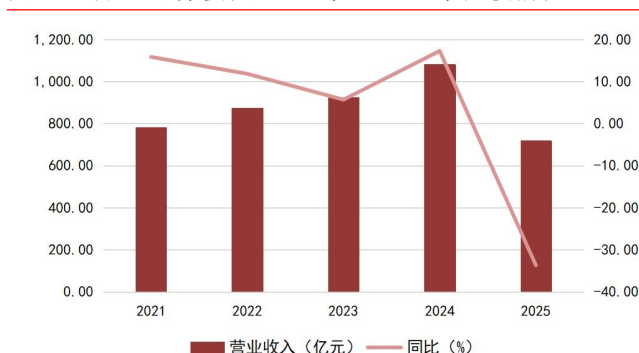
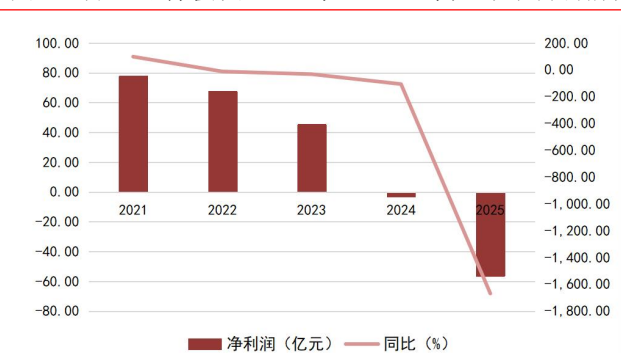


图 38：分立器件板块 2021 年—2025 年归母净利润情况

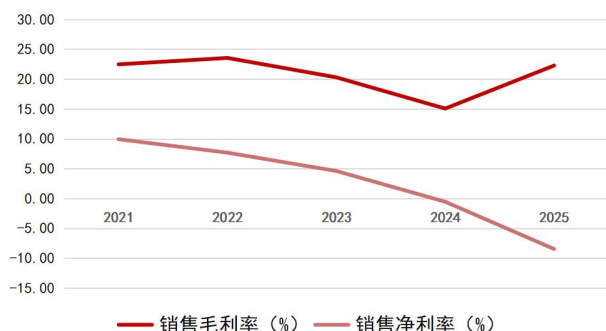


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

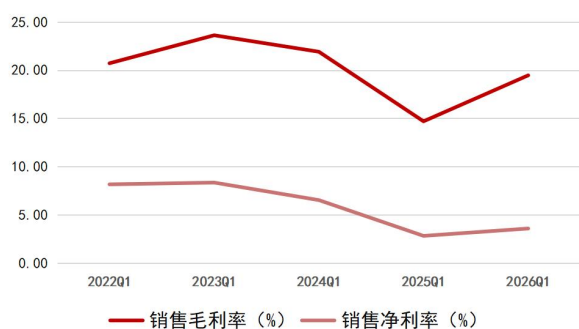
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 39：分立器件板块 2022Q1-2026Q1 营收情况

图 40：分立器件板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况



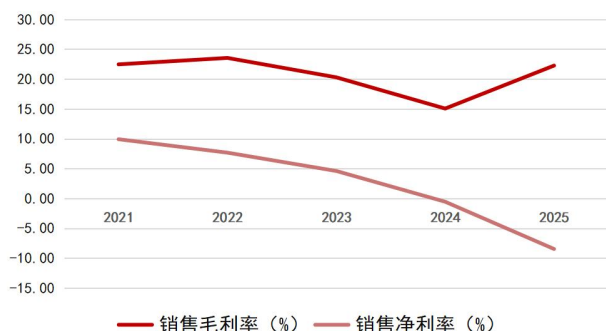
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



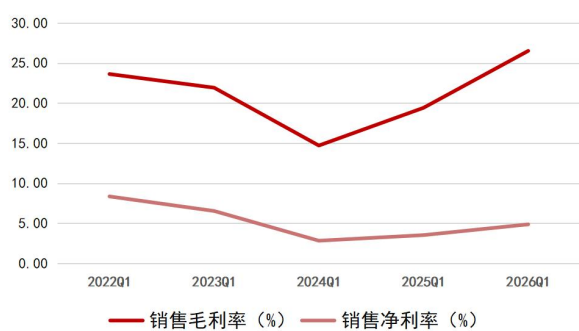
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

盈利能力。分立器件板块 2025 年销售毛利率为 22.25%，同比提高 7.20 个百分点，销售净利率为-8.48%，同比下降 7.92 个百分点；2026Q1 销售毛利率为 26.51%，同比提高 7.10 个百分点，销售净利率为 4.86%，同比提高 1.34 个百分点。

图 41: 分立器件板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率(%)图 42: 分立器件板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

2.7 集成电路制造：26Q1 营收同比+10.90%，归母净利润同比+23.20%

板块业绩。集成电路制造板块 2025 年实现营收 1162.82 亿元，同比+15.87%，实现归母净利润 75.50 亿元，同比+75.45%。板块 26Q1 实现营收 302.44 亿元，同比+10.90%，26Q1 实现归母净利润 17.15 亿元，同比+23.20%。

图 43: 集成电路制造板块 2021 年—2025 年营收情况

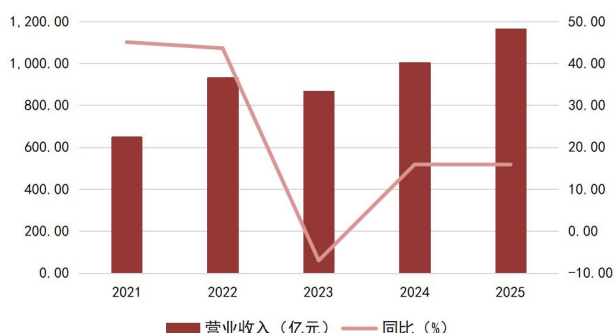
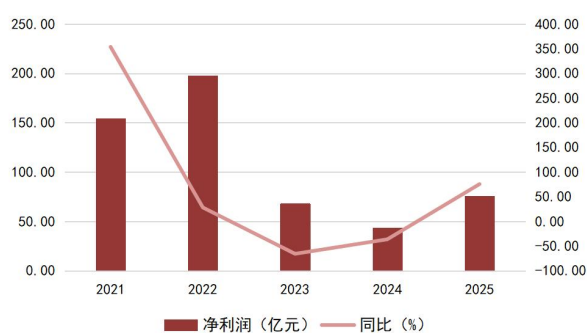
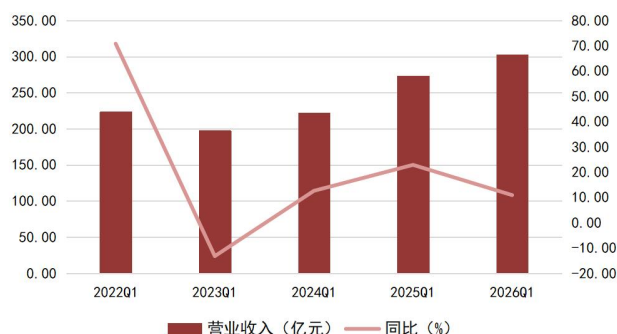


图 44: 集成电路制造板块 2021 年—2025 年归母净利润情况



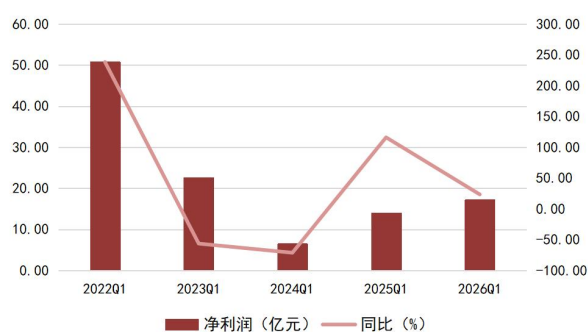
资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 45：集成电路制造板块 2022Q1-2026Q1 营收情况



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 46：集成电路制造板块 2022Q1-2026Q1 归母净利润情况

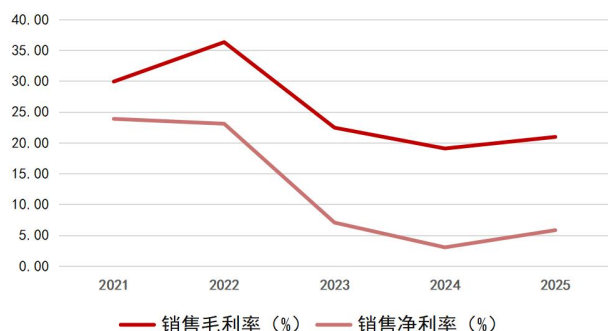


资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

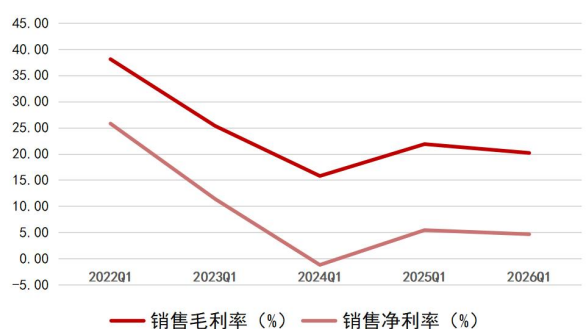
盈利能力。集成电路制造板块 2025 年销售毛利率为 20.94%，同比提高 1.88 个百分点，销售净利率为 5.82%，同比提高 2.79 个百分点；2026Q1 销售毛利率为 20.18%，同比下降 1.68 个百分点，销售净利率为 4.66%，同比下降 0.78 个百分点。

图 47：集成电路制造板块 2021 年—2025 年毛利率、净利率（%）



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

图 48：集成电路制造板块 2022Q1-2026Q1 毛利率、净利率



资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

3. 投资建议

投资建议：

人工智能与国产替代双轮驱动，半导体板块 2025 年、2026 年一季度景气高企，营收、归母净利润实现同比高增，且利润端表现明显优于收入端。据 SIA，2026 年 1—3 月，全球半导体销售额合计同比增长 62.51%，国内半导体销售额合计同比增长 59.88%，显示 AI 需求驱动下行业景气度持续提升，CPU、存储、算力芯片等核心环节持续紧缺。建议关注：存储、CPU、先进封装、模拟芯片、半导体设备与材料等高景气环节。

建议关注标的：

北方华创（002371）、长川科技（300604）、盛美上海（688082）、江丰电子（300666）、

路维光电（688401）、兆易创新（603986）、佰维存储（688525）、乐鑫科技（688018）、圣邦股份（300661）、思瑞浦（688536）、豪威集团（603501）、思特威（688213）、海光信息（688041）、通富微电（002156）。

4. 风险提示

终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。

表 1：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2026/5/21）

股票代码	股票名称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级	评级变动
			2025A	2026E	2027E	2025A	2026E	2027E		
002371	北方华创	662.99	7.62	10.85	14.62	87.00	61.09	45.34	买入	维持
300604	长川科技	234.77	2.10	3.33	4.51	111.58	70.57	52.02	买入	维持
688082	盛美上海	212.72	2.91	4.00	4.76	73.17	53.22	44.73	买入	维持
300666	江丰电子	191.02	1.88	3.11	4.19	101.47	61.46	45.54	买入	维持
688401	路维光电	69.52	1.30	1.88	2.66	53.34	37.04	26.10	买入	维持
603986	兆易创新	431.90	2.47	5.39	7.84	175.02	80.13	55.09	买入	维持
688525	佰维存储	301.00	1.83	12.51	13.81	164.83	24.07	21.80	买入	维持
688018	乐鑫科技	177.72	2.98	3.93	5.19	59.67	45.21	34.24	买入	维持
300661	圣邦股份	109.62	0.88	1.21	1.64	124.24	90.60	66.84	买入	维持
688536	思瑞浦	289.70	1.25	2.42	3.52	230.93	119.71	82.30	买入	维持
603501	豪威集团	102.66	3.34	3.62	4.48	30.70	28.38	22.90	买入	维持
688213	思特威	108.82	2.49	3.47	4.52	43.72	31.39	24.06	买入	维持
688041	海光信息	307.00	1.09	1.94	2.88	280.39	158.25	106.76	买入	维持
002156	通富微电	61.76	0.80	1.03	1.29	76.90	60.00	48.02	买入	维持

资料来源：同花顺 iFind，东莞证券研究所

注：除北方华创、圣邦股份、兆易创新、思瑞浦外，其他公司 2026/2027 年 EPS 采用同花顺一致预测值

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内
行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A 股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：www.dgzq.com.cn